

2025年度 大阪公立大学 半導体デバイスプロセス技術基礎講座（会員有料制）

於:大阪公立大学 i-siteなんば および オンライン



主催 大阪公立大学 協創研究センター
半導体超加工・集積化技術研究所

第1回	4月21日(月)	国内・世界の半導体および市場動向と展望(仮)	和田木 哲哉 氏	モルガンスタンレーMUFJ証券(株)
第2回	5月12日(月)	半導体多層配線プロセス：基礎/材料/プロセス/信頼性(仮)	松永 範昭 氏	アプライドマテリアルズジャパン(株)
第3回	6月13日(金)	半導体洗浄・乾燥技術の過去・現在・未来	服部 毅 氏	Hattori Consulting International
第4回	6月17日(火)	サーマルマネジメント技術の基礎と現状(仮)	西 剛伺 教授	足利大学 工学部
第5回	7月8日(火)	プリント配線板の基礎および最新の応用展開 (仮)	戸田 光昭 氏	(株)メイコー
第6回	7月24日(木)	CMP技術の基礎と最先端応用(仮)	土肥 俊郎 氏	(株)Doi Laboratory
第7回	8月25日(月)	エピタキシャル成長と最先端CMOS技術(仮)	小椋 厚志 教授	明治大学 理工学部
第8回	9月12日(金)	リソグラフィの基礎と最先端の現状(仮)	永原 誠司 氏	ASMLジャパン

3月15日現在

学内諸事情により手続き開始は2025年4月～となります。
原則15時半開始でセミナー（2時間50分、休憩、質疑応答込）＋講師を含む名刺交換会（1時間強）

後期の予定は5月頃にご案内致します